

08

Формирование наноразмерных пленок SiO₂ на поверхности свободной пленочной системы Si/Cu при имплантации ионов O₂⁺

© Б.Е. Умирзаков, М.К. Рузибаева, З.А. Исаханов, Р.М. Ёркулов

Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН Узбекистана,
100125 Ташкент, Узбекистан
e-mail: za.isakhanov@gmail.com

Поступило в Редакцию 25 мая 2018 г.

В окончательной редакции 25 мая 2018 г.

Принято к публикации 1 декабря 2018 г.

Исследованы состав и параметры энергетических зон тонких пленок SiO₂, полученных на поверхности свободной системы Si/Cu. Показано, что в отличие от пленок SiO₂, созданных на поверхности толстых пленок, значение E_g для тонких пленок SiO₂ составляет всего лишь ~ 4.1 eV. Это объясняется наличием в пленке SiO₂ примесных атомов Si и нестехиометрических окислов из-за невозможности прогрева системы выше температуры 700 К.

DOI: 10.21883/JTF.2019.06.47643.210-18

Введение

Использование наноразмерных материалов в создании различных гетероструктур для современных приборов электроники требует получения наиболее полной информации о концентрации примесных атомов на поверхности и их распределении по глубине. Поэтому в настоящее время широко исследуются нанопленки и нанокристаллы силицидов металлов и другие полупроводниковые соединения, полученные различными методами в условиях сверхвысокого вакуума на поверхности Si, а также многослойные системы Si–Me–Si–Me, на основе которых разрабатываются современные приборы микро- и наноэлектроники [1–5]. В частности, хорошо изучены морфология, состав и электронные свойства наноразмерных структур, созданных на поверхности полупроводниковых и диэлектрических образцов методом ионной имплантации [6–8]. Влияние имплантации ионов на свойства свободных пленок полупроводников (в том числе Si) проводилось нами в [9], где исследовано влияние имплантации ионов Co⁺ на состав поверхности и профили распределения атомов по глубине системы Si–Cu(100). После прогрева ионно-имплантированного образца, сформировалась пленка CoSi₂ толщиной $d = 5.0$ – 6.0 nm. Обнаружено, что после ионной имплантации глубина проникновения Cu в Si увеличивается ~ 2 раза.

В настоящей работе впервые приводятся экспериментальные результаты исследования влияния имплантации ионов O₂⁺ на состав поверхности и профили распределения атомов по глубине системы Si/Cu(100).

Методика эксперимента

Исследуемые трехслойные свободные пленки Si–Cu получены методом термического испарения в двух

отдельных СВВ-установках [10]. В первой установке на нагретую поверхность ($T \approx 450$ К) монокристалла NaCl (100) осаждается пленка Cu толщиной $d \approx 40$ nm при вакууме не хуже 10^{-5} Pa. Затем пленка Cu отделяется от кристалла соли NaCl путем опускания ее в дистиллированную воду, и свободная пленка, которая осталась над водой, вылавливается мелкоструктурной сеткой из меди. Полученная пленка помещается в другую сверхвысоковакуумную камеру и на свежеполученную поверхность пленки Cu осаждаются атомы Si, испаряемые электронной бомбардировкой, до требуемой толщины (от 10 до 50 nm). Эти образцы устанавливались в универсальную СВВ-установку. Имплантация ионов, прогрев и все исследования проводились в одной и той же экспериментальной установке при вакууме не хуже 10^{-6} Pa. Состав и структура поверхности исследованы методами электронной оже-спектроскопии (ЭОС) и дифракции медленных электронов (ДМЭ). Пленки SiO₂ были аморфными. Параметры энергетических зон оценивались по спектрам фотоэлектронов (ФЭС). Профили распределения атомов по глубине определялись методом ЭОС в сочетании с послойным травлением ионами аргона, с $E_0 = 2$ keV под углом 5 – 10° относительно поверхности образца.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Перед ионной имплантацией образцы Si/Cu обезгаживались при $T = 700$ – 750 К в течение 2 – 3 h в условиях сверхвысокого вакуума ($P \leq 10^{-5}$ Pa). Результаты ЭОС показали, что после прогрева на поверхности Si концентрация кислорода составляет ~ 4 – 5 at.%, а углерода ~ 2 at.%. При этом на границе системы Si/Cu образуется переходной слой силицида Cu₂Si₃ толщиной $d = 8$ – 10 nm [9]. В настоящей работе основные

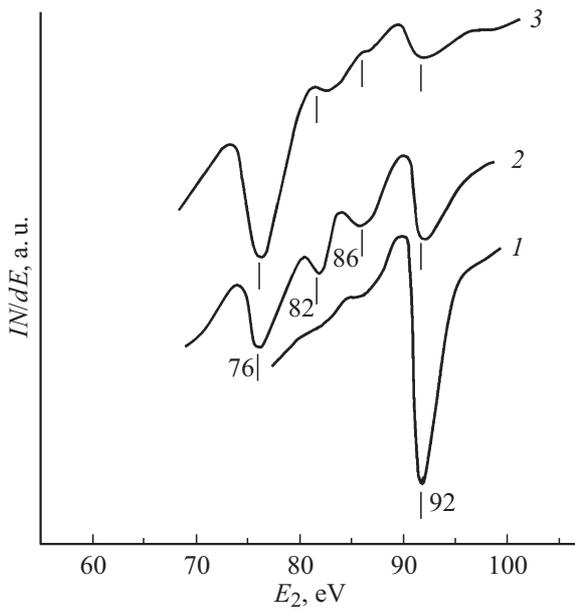


Рис. 1. Влияние имплантации ионов O_2^+ и последующего отжига на оже-пик $L_{2,3}VV$ кремния: 1 — Si; 2 — после имплантации ионов O_2^+ с $E_0 = 1 \text{ keV}$, при $D \approx 6 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-2}$; 3 — после отжига при $T \approx 700 \text{ K}$.

исследования проводились для системы Si/Cu₂Si₃/Cu, где $d_{Si} = 40 \text{ nm}$, $d_{Cu_2Si_3} \approx 10 \text{ nm}$, $d_{Cu} \approx 40 \text{ nm}$. Имплантация ионов O_2^+ проводилась с энергией $E_0 = 1 \text{ keV}$, при дозе насыщения $D \approx D_{sat} \approx 6 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-2}$.

На рис. 1 приведены изменение формы и положения оже-пика $L_{2,3}VV$ кремния ($E = 91 \text{ eV}$) в процессе имплантации ионов O_2^+ и последующего отжига. Видно, что после ионной имплантации интенсивность пика Si уменьшается до 2–2.5 раза, и появляются новые пики при энергиях 76, 82, 86 eV, характерные для нестехиометрических окислов. Анализ полного спектра ОЭС показал, что при этом на поверхности содержатся окислы типа SiO₂, SiO и Si₂O, а также избыточные атомы Si и O. Общая концентрация Si лежит в пределах $\sim 45\text{--}50 \text{ at.}\%$, а O $\sim 50\text{--}55 \text{ at.}\%$. После прогрева при $T = 700 \text{ K}$ пик с энергией 76 eV, характерный для SiO₂, резко увеличивается, а интенсивности других пиков уменьшается до минимума. Расчеты показали, что при этом поверхностная концентрация SiO₂ составляет $\sim 90\text{--}92 \text{ at.}\%$, Si $\sim 5\text{--}6 \text{ at.}\%$, нестехиометрических окислов $\sim 5\text{--}7 \text{ at.}\%$. В случае толстых пленок увеличением температуры прогрева до 850–900 K можно получить однородные пленки SiO₂ без указанных примесей. В случае свободных пленок с $T \approx 750 \text{ K}$ начинается испарение атомов легирующих элементов из подложки и поэтому принципиально невозможно получение „безпримесных“ пленок SiO₂ с высокой стехиометрией.

На рис. 2 приведены профили распределения атомов O, Si и Cu по глубине d , нанопленочной системы Si–Cu. Видно, что после ионной имплантации концентрация кремния в приповерхностном слое с толщиной

$d \approx 2.5\text{--}3 \text{ nm}$ составляет $\sim 45\text{--}50 \text{ at.}\%$, а концентрация кислорода $\sim 50\text{--}60 \text{ at.}\%$. В интервале $d \approx 2.5\text{--}10 \text{ nm}$ C_{Si} увеличивается до $\sim 80\text{--}90 \text{ at.}\%$, C_O уменьшается на $\sim 35\text{--}40 \text{ at.}\%$. Затем с ростом глубины зависимость $C_{Si}(d)$ проходит через максимум при $d \approx 15\text{--}20 \text{ nm}$, а концентрация C_O уменьшается практически до нуля. В интервале $d \approx 20\text{--}40 \text{ nm}$ концентрация C_{Si} уменьшается на 25–30 at.%, что обусловлено наличием в этих слоях атомов Cu вследствие диффузии Cu в пленку Si из системы Cu₂Si₃/Cu [6]. На границе раздела Si/Cu₂Si₃ наблюдается появление некоторого количества кислорода. В пленке Cu₂Si₃ концентрация Si составляет $\sim 55\text{--}60 \text{ at.}\%$, в пленке Cu концентрация Si резко уменьшается с глубиной и при $d \approx 60\text{--}65 \text{ nm}$ не превышает $\sim 2\text{--}3 \text{ at.}\%$. Прогрев этой системы при $T = 700\text{--}750 \text{ K}$ приводит к образованию на поверхности Si пленки SiO₂ толщиной $d \sim 1.5\text{--}2 \text{ nm}$, следовательно, формируется четырехслойная нанопленочная система SiO₂/Si/Cu₂Si₃/Cu (рис.3).

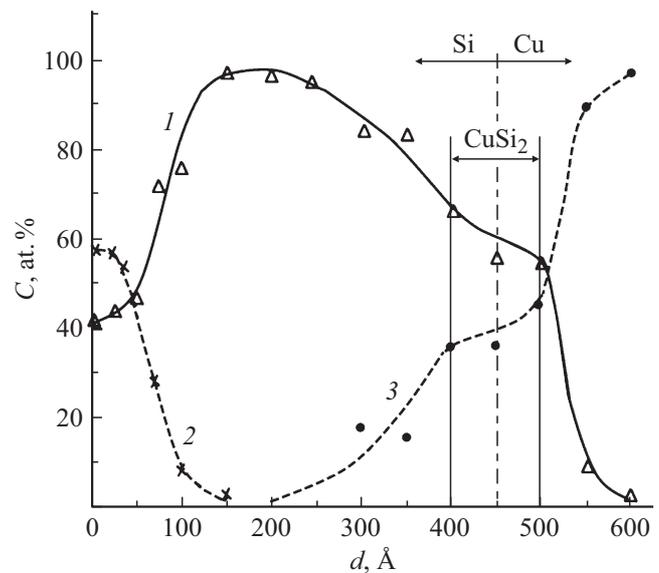


Рис. 2. Профили распределения атомов Si, Cu и O по глубине свободной пленочной системы Si/Cu, имплантированной ионами O_2^+ с $E_0 = 1 \text{ keV}$ при $D \approx 6 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-2}$: 1 — Si; 2 — O; 3 — Cu.

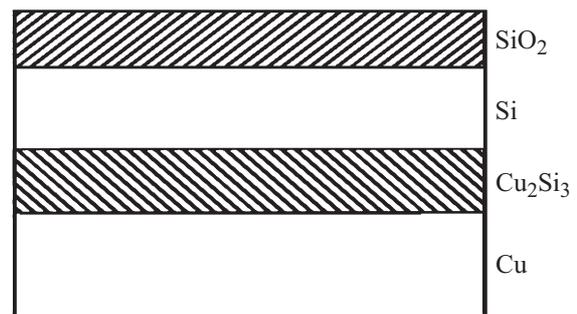


Рис. 3. Условный схематический разрез системы SiO₂/Si/Cu₂Si₃/Cu.

Зависимость ширины запрещенной зоны E_g окиси кремния от вида и толщины пленки кремния

Подложка	Энергия ионов O ₂ ⁺ , keV	T, К	Толщина пленок SiO ₂ , nm	Концентрация свободных атомов Si в SiO ₂ , at.%	E_g , eV
Свободная пленка Si, $d_{Si} = 40$ nm	1	700	1.5–2.0	8–10	4.1
Толстая пленка Si, $d_{Si} = 1000$ nm	1	850	1.5–2.0	2–3	7.3
	3	900	5.0–6.0	–	8.9

В таблице приведены значения ширины запрещенной зоны нанопленок SiO₂, полученной на поверхности свободной пленки Si/Cu и толстой пленки Si, методом ионной имплантации в сочетании с отжигом. Из таблицы видно, что наличие в пленке SiO₂ большого количества несвязанных атомов Si существенно уменьшает ширину запрещенной зоны окиси кремния.

Заключение

Таким образом, имплантация ионов O₂⁺ в свободную систему Si/Cu в сочетании с отжигом позволяет получить нанопленки SiO₂ толщиной $d \sim 1.5–2$ nm. При этом в пленке SiO₂ содержится заметное количество несвязанных атомов Si (5–6 at.%) и нестехиометрических окислов. Это приводит к уменьшению ширины запрещенной зоны E_g в SiO₂ в два и более раз.

Список литературы

- [1] Landry O., Bougerol C., Renevier H., Daudin B. // Nanotechnology. 2009. Vol. 20. N 41. P. 415602.
- [2] Wang D., Zou Z.-Q. // Nanotechnology. 2009. Vol. 20. N 27. P. 275607.
- [3] Домашевская Э.П., Терехов В.А., Турицев С.Ю., Коюда Д.А., Румянцев Н.А., Першин Ю.П., Кодратенко В.В., Arrathurai N. // ФТТ. 2013. Т. 55. Вып. 3. С. 577–584.
- [4] А.А. Алексеев, Д.А. Олянич, Т.В. Утас, В.Г. Котляр, А.В. Зотов, А.А. Саранин // ЖТФ. 2015. Т. 85. Вып. 10. С. 94–100.
- [5] В.М. Ротштейн, Р.Х. Ашуров, Т.К. Турдалиев, И.Х. Ашуров. // Uzbek J. Phys., 2017. № 4. С. 12.
- [6] Мурадкбиллов Д.М., Ташмухамедова Д.А., Умирзаков Б.Е. // Поверхность. Рентген, синхротрон и нейтрон. исследования. 2013. № 10. С. 58–62. [Muradkabilov D.M., Tashmukhamedova D.A., Umirzakov B.E. // J. Surf. Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniq. 2013. Vol. 7. N 5. September, P. 967–971.]
- [7] Умирзаков Б.Е., Ташмухамедова Д.А., Рузибаева М.К., Ташатов А.К., Донаев С.Б., Мавлянов Б.Б. // ЖТФ. 2013. Т. 83. Вып. 9. С. 146–149. [Umirzakov B.E., Tashmukhamedova D.A., Ruzibaeva M.K., Tashatov A.K., Donaev S.B., Mavlyanov B.B. // Technic. Physics. 2013. Vol. 58. N 9. P. 1383–1386.]
- [8] Шаропов У.Б., Атабаев Б.Г., Джаббарганов Р., Курбанов М.К. // Поверхность. Рентген, синхротрон и нейтрон. исследования. 2016. № 2. С. 1–5. [Sharopov U.B., Atabaev B.G., Djabbarganov R., Kurbanov M.K. // J. Surf. Investigation: X-ray, Synchrot. and Neutron Techniq. 2016. Vol. 10. N 1. P. 250–254.]
- [9] Исаханов З.А., Кодиров Т., Халматов А.С., Рузибаева М.К., Мухтаров З.Э., Умирзаков Б.Е. // Поверхность. Рентген, синхротрон и нейтрон. исслед. 2017. № 1. С.100–103. [Isakhanov Z.A., Kodirov T., Halmatov A.S., Ruzibaeva M.K., Muhtarov Z.E., Umirzakov B.E. // J. Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniq. 2017. Vol. 11. N1. P.152–154.]
- [10] Умирзаков Б.Е., Исаханов З.А., Рузибаева М.К., Мухтаров З.Э., Халматов А.С. // ЖТФ. 2015. Т. 85. Вып. 4. С. 123–125. [Umirzakov B.E., Isakhanov Z.A., Ruzibaeva M.K., Mukhtarov Z.E., Khalmatov A.S. // Technic. Phys. 2015. Vol. 60. N 4. P. 600–602.]